

COMPANY RESEARCH AND ANALYSIS REPORT

|| 企業調査レポート ||

フェローテックホールディングス

6890 東証スタンダード市場

企業情報はこちら >>>

2023 年 6 月 22 日 (木)

執筆：客員アナリスト

寺島 昇

FISCO Ltd. Analyst **Noboru Terashima**



FISCO Ltd.

<https://www.fisco.co.jp>

目次

■ 要約	01
1. 2023 年 3 月期業績（実績）	01
2. 2024 年 3 月期業績（予想）	01
3. 中期経営計画	02
■ 会社概要	03
1. 会社概要	03
2. 沿革	03
■ 事業概要	04
1. 事業セグメント	04
2. 半導体等装置関連	04
3. 電子デバイス	06
4. その他	08
5. 特色、強み	08
■ 業績動向	09
1. 2023 年 3 月期の業績概要	09
2. セグメント別概況	12
3. 主な設備投資と減価償却費	13
■ 今後の見通し	13
1. 2024 年 3 月期の業績見通し	13
2. セグメント別見通し	15
3. 設備投資額と減価償却費の見通し	15
■ 中長期の成長戦略	16
1. 中期経営計画の概要（目標値の修正）	16
2. 基本方針と定量的目標（KPI）	16
3. 2026 年 3 月期の目標	18
4. グローバル戦略の強化	22
5. 経営基盤の強化	23
■ 株主還元策	23

フェローテックホールディングス
6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

要約

2023 年 3 月期は大幅増収増益だが、 2024 年 3 月期は半導体業界の一服で営業減益予想

フェローテックホールディングス <6890> の主力事業は、真空シール・金属加工、石英製品、セラミックス、CVD-SiC（化学蒸着法炭化ケイ素）、磁性流体、サーモモジュール、パワー半導体基板など様々な製品、装置、部品、素材等を製造・販売することだが、半導体製造装置メーカーやデバイスメーカー向けに各種部品等の洗浄や受託加工・組立サービスなどの事業も行っている。

1. 2023 年 3 月期業績（実績）

2023 年 3 月期の業績は、売上高が前期比 57.5% 増の 210,810 百万円、営業利益が同 55.1% 増の 35,042 百万円、経常利益が同 63.3% 増の 42,448 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同 11.4% 増の 29,702 百万円となった。世界的な半導体市場の活況を背景に、主要顧客である半導体製造装置メーカーやデバイスメーカーからの需要が高まり、売上高は過去最高となった。セグメント別の売上高は、半導体等装置関連が前期比 46.4% 増、電子デバイスが同 96.2% 増、その他が同 54.9% 増となった。営業外収益で為替差益 5,495 百万円（前期は差益 2,542 百万円）を計上したこと、営業外費用で持分法による投資損失 610 百万円を計上したことなどから経常利益の伸び率が高くなった。特別利益は、前期に計上した持分変動利益 9,327 百万円が減少したこと、前期比 8,565 百万円減となった。特別損失は、1,263 百万円（前期比 504 百万円減）であった。この結果、親会社株主に帰属する当期純利益の伸び率は経常利益に比べて小さくなった。設備投資額は 62,661 百万円（前期実績 35,378 百万円）と高水準であり、減価償却費は 12,618 百万円（同 8,085 百万円）となった。

2. 2024 年 3 月期業績（予想）

2024 年 3 月期の業績は、売上高 220,000 百万円（前期比 4.4% 増）、営業利益 32,500 百万円（同 7.3% 減）、経常利益は 30,000 百万円（同 29.3% 減）、親会社株主に帰属する当期純利益は 18,000 百万円（同 39.4% 減）を見込んでいる。世界的に半導体市場が踊り場を迎えている状況で、先行きも不透明であることから主力の半導体等装置関連は前期比 5.4% の減収を見込んでいる。一方で、注力しているパワー半導体基板が大きく伸びることから、電子デバイスは同 33.4% 増の予想。その他は同 5.4% 減を見込んでいる。その結果、営業利益は減益予想となっており、為替差益やその他の特殊要因を見込んでいないことから、経常利益以下の減益率が高くなっている。設備投資額は 96,900 百万円、減価償却費は 17,400 百万円を見込んでいる。なお 2028 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（社債の総額 250 億円、2023 年 6 月 23 日払い込み、転換価額 4,020 円）の発行を発表した。

フェローテックホールディングス

6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)

<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

要約

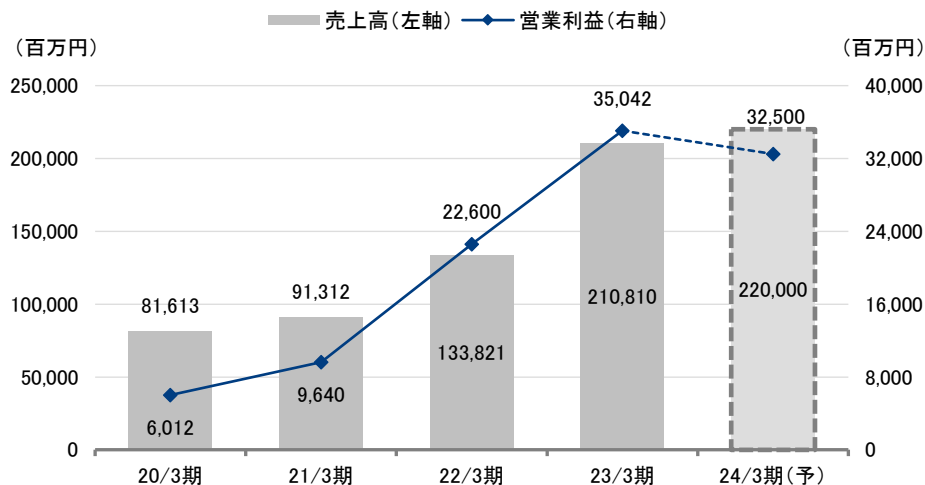
3. 中期経営計画

同社は、2021 年 5 月に 2024 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画を発表した。2024 年 3 月期の定量的目標を、当初の目標値から 2022 年 5 月に一度は上方修正したが、足元の状況を鑑みて 2023 年 5 月に下方修正した。現在では売上高 2,200 億円、営業利益 325 億円（営業利益率 14.8%）、親会社株主に帰属する当期純利益 180 億円を目標としている。この目標を達成するための累計設備投資額（2022 年 3 月期～2024 年 3 月期）は、2022 年 5 月修正後の 1,800 億円から 1,950 億円へ上方修正された。引き続き成長ドライバーとして、半導体マテリアル（石英製品、セラミックス、シリコンパーツ等）、半導体サービス（部品洗浄、石英坩堝、再生ウエーハ等）、半導体金属・装置（金属加工、蒸着装置等）、電子デバイス（サーモモジュール、パワー半導体基板等）を挙げており、この方針は当初計画と変わっていない。さらに中期経営計画後の目標としては、2025 年 3 月期に売上高 2,700 億円、営業利益 450 億円、2026 年 3 月期に売上高 3,600 億円、営業利益 600 億円を掲げている。今後の動向に注目したい。

Key Points

- ・石英製品、セラミックス等の無機系製品の大手メーカー。半導体業界向けが多い
- ・半導体業界の一服で 2024 年 3 月期は営業減益（前期比 7.3% 減）を見込むが、設備投資は高水準。
- ・中期経営計画後の 2025 年 3 月期以降は再度成長路線を目指す

業績推移



出所：決算短信よりフィスコ作成

フェローテックホールディングス
6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

■ 会社概要

**シリコン、セラミックス等無機系製品の大手メーカー。
主に半導体製造装置メーカーやデバイスメーカー向けに多種多様な
部品・製品を供給**

1. 会社概要

同社は 2023 年 3 月末現在で、傘下に連結子会社 73 社、持分法適用子会社 9 社を擁する純粋持株会社である。元々は 1980 年に米国 Ferrofluidics Corporation (現 Ferrotec (USA) Corporation) の日本法人 (旧 日本フェローフルイディクス (株)) として設立されたが、その後、親会社から分離独立し独自路線を歩んでいる。

現在の主力事業は、真空シール・金属加工、石英製品、セラミックス、CVD-SiC、磁性流体、サーモモジュール、パワー半導体基盤など主に無機材料を使った様々な製品、装置、部品、素材等の製造である。また、半導体製造装置メーカーやデバイスメーカー向けに各種部品等の洗浄や受託加工・組立サービスなどの事業も行っている。そのため、世界的に著名な大手半導体製造装置メーカーが主要顧客となっている。

2. 沿革

同社の歴史は非常にユニークである。1980 年に米国企業の日本法人として設立され、親会社製品 (真空シール等) の輸入販売が主たる業務であったが、1982 年には千葉県に工場を建設し、自社生産を開始した。自社製品比率が高まるにつれて、親会社との関係が薄れてきたため、1987 年には親会社から完全に独立し、独自路線を歩み始めた。その後も HDD 用ラミネートシール、超高真空用フッ素系磁性流体などの自社製品を開発し、1992 年には初の中国拠点 (杭州市) を設立、1995 年には中国 2 番目の製造拠点を上海市に設立し、さらに同年に社名を「株式会社フェローテック」に改称した。

その後も製品群や事業の拡大を続け、1999 年には元の親会社である Ferrofluidics Corporation を友好的 TOB により子会社化した。21 世紀に入ってから、2001 年に米国 Amerigon Incorporated (現 Gentherm Incorporated) と自動車温調システムで業務提携、2002 年には中国上海工場で小口径シリコンウエーハの受託加工を開始、2005 年にはロシアのサーモモジュールメーカー SCTB NORD を子会社化した。さらに 2010 年には英国 Edwards Vacuum Inc. から真空蒸着装置事業を取得し、2011 年には中国銀川市に大型工場を新設、2015 年には CVD-SiC 製品の製造・販売を行う (株) アドマップ現 (株) フェローテックマテリアルテクノロジーズに、2016 年には産業用クリーニング機器の製造・販売を行う (株) アサヒ製作所に資本参加して子会社化し、事業の拡大を続けた。2017 年春には持株会社制に移行し、現在では日本、欧州、アメリカ、中国、東南アジアなど世界 9 ヶ国に製造子会社及び販売会社を有する国際的な企業となっている。

株式については、1996 年 10 月に日本証券業協会へ店頭登録し、現在は東京証券取引所スタンダード市場に上場している。

フェローテックホールディングス
6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

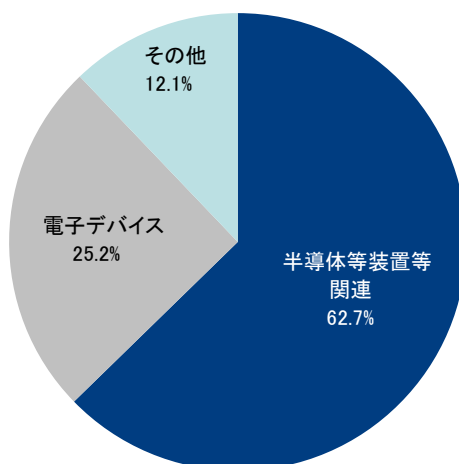
■ 事業概要

事業内容は多岐にわたる。主力は半導体等装置関連事業。

1. 事業セグメント

同社は多くの製品を自社開発・製造すると同時に M&A によって多くの企業を子会社化してきたことから、事業内容は多岐にわたっている。現在の事業セグメントは半導体等装置関連（2023 年 3 月期売上高比率 62.7%）、電子デバイス（同 25.2%）、その他（同 12.1%）に分かれる。

セグメント別売上高比率
(2023年3月期:210,810百万円)



出所：決算説明資料よりフィスコ作成

2. 半導体等装置関連

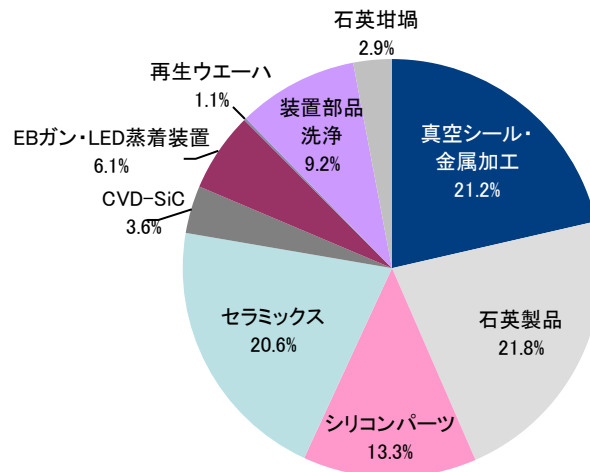
このセグメントは、さらに真空シール・金属加工、石英製品、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC、EB ガン・LED 蒸着装置、ウエーハ加工、再生ウエーハ、装置部品洗浄、石英坩堝のサブセグメントに分かれる。

フェローテックホールディングス
6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

事業概要

半導体等装置関連サブセグメント別売上高比率 (2023年3月期:132,194百万円)



出所：決算説明資料よりフィスコ作成

(1) 真空シール・金属加工 (2023 年 3 月期対総売上高比率 13.3%)

磁性流体を利用して、真空雰囲気内への回転導入機としての役割を担う部品で、半導体・FPD・LED・太陽電池等の製造工程で利用されている。同社の核となる製品で、主に半導体ウエーハのエッチングや成膜工程、FPDのパネル搬送用ロボット回転機構部などに導入され、密閉空間を外部から隔離しつつ加工に必要な動力を正確に伝えることを可能にしている。

(2) 石英製品 (同 13.7%)、シリコンパーツ (同 8.3%)

石英製品は熱と化学変化に強い超高純度のシリカガラスからなり、ウエーハの成膜生成や拡散プロセスなどで使われるほか、搬送や洗浄工程で治具、消耗品として使われており、微細化・高純度化が進む半導体製造プロセスのなかで重要な役割を担っている。シリコンパーツ（ポート、インジェクター、フォーカスリング等）は、加工して主に半導体製造工程等で使われる。

(3) セラミックス (同 12.9%)

同社が持つ素材技術、生産技術、精密加工技術を生かして様々なセラミックス製品を提供している。セラミックス製品は高強度・高純度・高耐熱性に優れたファインセラミックス（FC）製品と高度な機械加工が可能なマシナブルセラミックス（MC）製品に分けられる。前者は主に半導体製造装置用の部品として使われているが、特にドライエッチング方式（プラズマエッチャー）では不可欠な部品となっている。後者は様々な加工を施すことで各種部品や治具として利用されるが、特に半導体の検査工程での治具（ウエーハプロバー用）として需要が高まっている。また近年では、その精密加工特性を生かして高度な医療用機器での利用も進んでいる。

フェローテックホールディングス

6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)

<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

事業概要

(4) CVD-SiC (同 2.3%)

独自の CVD 方式による炭化ケイ素 (SiC) 製品で、超高純度・高耐熱性・高対摩耗性・耐腐食性といった特性を備えている。半導体製造工程で用いられるウエーハポートやチューブ、シリコンウエーハの代替となるダミーウエーハなど、主に高温で使用される治具として幅広く活用されている。

(5) EB ガン・LED 蒸着装置 (同 3.8%)

EB (Electron Beam) ガンとは電子銃のことで、高機能な EB ガンと高圧電源を心臓部とした米国製 Temescal 装置 (精密蒸着装置) によって基盤などに薄膜を形成する。同社は大学や研究所向けの小規模生産用タイプから、大規模生産用高スループットタイプまで幅広い製品群を揃えている。次世代通信などで利用が見込まれる化合物半導体での世界標準機として数多くの顧客に使用されており、現在では LED や通信チッププロセス等の導入が進んでいる。

(6) ウエーハ加工 + 再生ウエーハ (同 0.8%)

ウエーハ加工はシリコンウエーハ (集積回路の基盤材料) の製造である。また 2022 年 3 月期より、中国半導体国産化の加速による需要の急増を受けて、新たに再生ウエーハ事業を立ち上げた。再生ウエーハとは、設備の確認やテストで使用したダミーウエーハを研磨加工することで繰り返し使えるようにしたウエーハのことである。半導体の生産が高まると、それに伴い再生ウエーハの需要も高まる。

(7) 装置部品洗浄 (同 5.8%)

半導体製造装置用部品の洗浄作業を行う。

(8) 石英坩堝 (同 1.8%)

同社の石英坩堝は、半導体製造工程に不可欠な石英製品と同等の高純度の原料を使用し、単結晶シリコンの原料を充填する容器として使用されている。半導体用、太陽電池用などの単結晶シリコンを製造するメーカーが主な顧客である。今後は、太陽光発電向け大口径シリコン製造用の比率を高めることで売上高を伸ばす方針である。

3. 電子デバイス

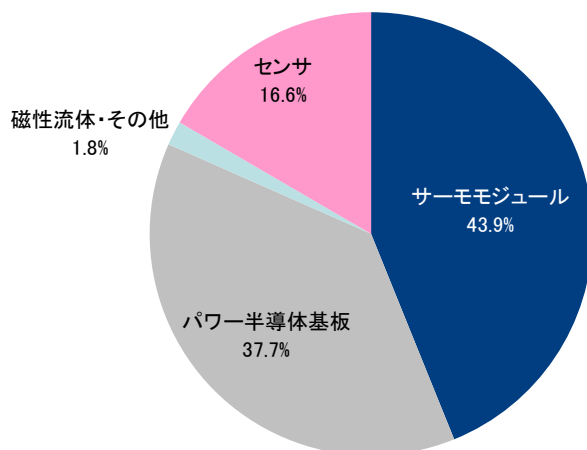
電子デバイスは、サーモモジュール、パワー半導体基板、磁性流体・その他、センサの 4 つのサブセグメントに分かれる。

フェローテックホールディングス
6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

事業概要

電子デバイスサブセグメント別売上高比率 (2023年3月期:53,024百万円)



出所：決算説明資料よりフィスコ作成

(1) サーモモジュール (2023 年 3 月期対総売上高比率 11.0%)

サーモモジュールは、2 種類の金属の接合部に電流を流すと、片方の金属からもう片方へ熱が移動するという効果を利用した板状の半導体冷熱素子（ペルチェ素子）である。小型・軽量でフロン要らずといった特長があり、自動車の温調シートをはじめ、冷却チラー、光通信、バイオ、エアコン、ドライヤーなど様々な家電製品にも採用されている。

(2) パワー半導体基板 (同 9.5%)

パワー半導体基板とは、サーモモジュール製造技術を応用して、アルミナや窒化アルミニウムセラミックスに銅回路板を接合した放熱用絶縁基板のことである。同製品は、電車や電動車、エアコン、サーバー等の小型化・省エネ化に寄与しており、今後の需要増が期待される製品である。特に、自動車の EV 化が進むと、IGBT※などのハイパワー半導体が必要となり、その製造のためには同社の基板が必須部品となる。

※ IGBT とは、絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ（Insulated Gate Bipolar Transistor）の略で、パワートランジスタの一種。

(3) 磁性流体・その他 (同 0.4%)

磁性流体とは液体でありながら、外部磁場によって磁性を帯び、磁石に吸い寄せられる機能性素材である。1960 年代の NASA スペースプログラムで、無重力環境における燃料輸送等の目的で開発された。現在では、スピーカーやアクチュエーター、センサ、分別リサイクル用途のほか、同社の主力製品の 1 つである真空シールにも利用されている。

(4) センサ (同 4.2%)

2022 年 8 月から連結子会社となった（株）大泉製作所が製造するサーミスタセンサや関連する部品などが含まれる。2023 年 3 月期第 2 四半期から連結決算に加算されている。

事業概要

4. その他

その他には、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品、子会社アサヒ製作所のリネン系洗剤、受託作業等が含まれる。

5. 特色、強み

(1) 無機系素材のパイオニア

同社は石英、シリコン、窒化ケイ素、シリコンカーバイド (SiC) など幅広い無機系素材の生成、加工などに長年携わってきた。そのため、同社内にはこれらの素材に関する多くのノウハウ (素材の性質、生成方法、加工方法等) が蓄積されており、これが同社の特色でもあり強みと言える。

(2) 製造装置も手掛ける

同社は、素材だけでなく各種の製造装置も手掛けており、製造装置に関するノウハウも持っている。そのため顧客に対しては、素材、加工部品、最終製品、製造装置など様々な提案 (ソリューションの提供) を行うことができる。

(3) ワンストップソリューションが可能

同社の場合、半導体製造装置内の部品の洗浄 (取り外し、洗浄、据え付け) や製造装置の組立サービスなどの事業も展開しており、顧客にとっては素材の供給、部品加工、装置類の組立、部品洗浄などをワンストップで同社に対して外注化 (アウトソーシング) することが可能であり、これも同社の強みだろう。

(4) 大手顧客との関係：親密、スピード、信頼

同社の主要製品は、主に半導体製造装置向け及び半導体製造プロセスで使われるため、同社の主要顧客は世界でトップクラスの半導体製造装置メーカーが多い。ちなみに 2022 年 3 月期の売上高上位には、米国系製造装置メーカー 2 社、及び日本の製造装置メーカーが含まれる。同社はこれらの大手半導体製造装置メーカーに長年にわたり製品や部品を供給しており、これら顧客と常に親密かつ密接な対話を続けている。

このような大手ユーザーとの関係のなかから、同社では顧客の将来需要をいち早く察知し、必要と判断すればすぐに増産体制を整えている。言い換えれば、売上規模は大きくなったが、同社内には創業当時の「ベンチャー精神」が残っておりスピーディな決断・行動が取れている。その結果、さらに顧客からの信頼を得て親密な対話を続けることができる。このような好循環が続けられるのも同社の強みと言える。

フェローテックホールディングス
6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

業績動向

2023 年 3 月期は半導体需要の高まりにより 55.1% の営業増益。

1.2023 年 3 月期の業績概要

(1) 損益状況

2023 年 3 月期業績は、売上高が前期比 57.5% 増の 210,810 百万円、営業利益が同 55.1% 増の 35,042 百万円、経常利益が同 63.3% 増の 42,448 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が同 11.4% 増の 29,702 百万円となった。設備投資額は 62,661 百万円（前期実績 35,378 百万円）、減価償却費は 12,618 百万円（同 8,085 百万円）となった。世界的な半導体市場の活況を背景に、主要顧客である半導体製造装置メーカーやデバイスメーカーからの需要が高まり、売上高は過去最高となった。

売上総利益率は 34.2%（前期は 36.4%）と前期比で低下した。主に半導体等装置関連の売上高比率が下がったことによるが、減価償却費の増加も利益率を押し下げた。ただし大幅増収により、売上総利益は 72,081 百万円（同 48.1% 増）となった。一方で、新型コロナウイルス感染症拡大から社会経済活動が回復し、営業活動等が通常に戻ったことなどから販管費は 37,038 百万円（同 42.0% 増）と増加したが、売上総利益の伸び率を下回ったことから営業利益は前期比で大幅増益となった。

営業外損益では、主に営業外収益で為替差益 5,495 百万円（前期は差益 2,542 百万円）を計上し、営業外費用で持分法による投資損失 610 百万円を計上した。このため、経常利益の増益率は営業利益より大きくなった。特別利益は、前期に計上した持分変動利益 9,327 百万円が減少したこと、前期比 8,565 百万円減となった。一方で、特別損失が 1,263 百万円（前期比 504 百万円減）となったことから、親会社株主に帰属する当期純利益の増益率は経常利益の増益率に比べて大幅に小さくなった。

2023 年 3 月期の業績

(単位：百万円)

	22/3 期		23/3 期		増減額	前期比
	実績	売上比	実績	売上比		
売上高	133,821	100.0%	210,810	100.0%	76,989	57.5%
売上総利益	48,677	36.4%	72,081	34.2%	23,404	48.1%
販管費	26,076	19.5%	37,038	17.6%	10,962	42.0%
営業利益	22,600	16.9%	35,042	16.6%	12,442	55.1%
経常利益	25,994	19.4%	42,448	20.1%	16,454	63.3%
親会社株主に帰属する 当期純利益	26,659	19.9%	29,702	14.1%	3,043	11.4%
設備投資額	35,378	-	62,661	-	27,283	77.1%
減価償却費	8,085	-	12,618	-	4,533	56.1%

出所：決算短信、決算説明資料よりフィスコ作成

フェローテックホールディングス

6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)

<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

業績動向

高水準の設備投資が続き、資産は大幅増

(2) 財務状況

2023 年 3 月期末の財務状況は、流動資産は 215,341 百万円（前期末比 81,927 百万円増）となった。主に現金及び預金の増加 50,536 百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の増加 11,479 百万円、たな卸資産の増加 20,741 百万円による。現金及び預金が増加したのは、業績が堅調であることに加え、第三者割当増資を行った中国子会社の現金及び預金増加が主たる要因。（内訳は、洗浄事業会社 12,500 百万円増加、パワー基板事業会社 17,700 百万円増加、シリコンパーツ・坩堝事業会社 11,000 百万円増加）。固定資産は 195,306 百万円（同 63,948 百万円増）となった。主に設備投資による有形固定資産の増加 55,527 百万円、無形固定資産の増加 4,953 百万円（主に大泉製作所 TOB 及び東洋刃物 100% 子会社化によるのれんの増加）、投資その他の資産の増加 3,468 百万円（主に、投資有価証券の増加 4,500 百万円、中国の SIC デバイス等メーカー、安徽長飛先進半導体の株式取得 3,800 百万円など）であった。その結果、資産合計は 410,648 百万円（同 145,876 百万円増）となった。

負債合計は 160,991 百万円（前期末比 57,177 百万円増）となった。主に支払手形及び買掛金の増加 13,822 百万円、短期借入金の増加 14,054 百万円、1 年内返済予定の長期借入金（社債含む）の増加 7,324 百万円、社債の減少 4,723 百万円、転換社債型新株予約権付社債の減少 2,134 百万円、長期借入金の増加 14,636 百万円による。これにより、期末の有利子負債は 66,718 百万円（同 29,157 百万円増）となった。また純資産合計は 249,656 百万円（同 88,699 百万円増）となった。主に同社や子会社の増資による資本剰余金の増加 21,890 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加 26,339 百万円、円安による為替換算調整勘定の増加 3,349 百万円、ウエーハ子会社の非連結化による非支配株主持分の増加 35,999 百万円による。この結果、期末の自己資本比率は 44.7%（前期末 49.5%）となり、目標である 40% 超を維持した。

フェローテックホールディングス
6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

業績動向

連結貸借対照表

(単位：百万円)

	22/3 期末	23/3 期末	増減額
現金及び預金	52,579	103,115	50,536
受取手形、売掛金及び契約資産	41,797	53,276	11,479
たな卸資産	28,436	49,177	20,741
流動資産計	133,414	215,341	81,927
有形固定資産	84,083	139,610	55,527
無形固定資産	1,996	6,949	4,953
投資その他の資産	45,277	48,745	3,468
固定資産計	131,358	195,306	63,948
資産合計	264,772	410,648	145,876
支払手形及び買掛金	26,702	40,524	13,822
短期借入金	6,324	20,378	14,054
1 年内返済予定の長期借入金と社債	8,501	15,825	7,324
流動負債計	68,800	111,294	42,494
社債	8,806	4,083	-4,723
転換社債型新株予約権付社債	2,134	-	-2,134
長期借入金	11,796	26,432	14,636
固定負債計	35,014	49,697	14,683
負債合計	103,814	160,991	57,177
非支配株主持分	29,888	65,887	35,999
純資産合計	160,957	249,656	88,699

出所：決算短信、決算説明資料よりフィスコ作成

(3) キャッシュ・フローの状況

2023 年 3 月期の営業活動によるキャッシュ・フローは 43,024 百万円の収入であった。主な収入は税金等調整前当期純利益の計上 42,041 百万円、減価償却費 12,618 百万円、仕入債務の増加 6,516 百万円で、主な支出は、持分変動利益 651 百万円、売上債権の増加 3,139 百万円、たな卸資産の増加 14,354 百万円による。投資活動によるキャッシュ・フローは 68,760 百万円の支出であった。主に定期預金の増加による支出 7,029 百万円、有形固定資産の取得による支出 56,001 百万円、投資有価証券の取得による支出 4,607 百万円による。財務活動によるキャッシュ・フローは 68,718 百万円の収入であった。主な収入は長短借入金の増加（ネット）27,632 百万円、非支配株主からの払込みによる収入 47,607 百万円で、主な支出は社債の償還 2,658 百万円、配当金の支払額 3,532 百万円であった。

以上から 2023 年 3 月期の現金及び現金同等物は 43,326 百万円増加し、期末残高は 95,905 百万円となった。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	22/3 期	23/3 期
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,833	43,024
投資活動によるキャッシュ・フロー	-29,399	-68,760
財務活動によるキャッシュ・フロー	30,601	68,718
現金及び現金同等物の増減額	22,376	43,326
現金及び現金同等物の期末残高	52,579	95,905

出所：決算短信よりフィスコ作成

フェローテックホールディングス
6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

業績動向

半導体等装置関連と電子デバイスが業績を牽引

2. セグメント別概況

セグメント別状況を見ると、主力の半導体等装置関連は、売上高 132,194 百万円（前期比 46.4% 増）、営業利益 24,090 百万円（同 52.4% 増）、電子デバイスの売上高は 53,024 百万円（同 96.2% 増）、営業利益 11,178 百万円（同 67.1% 増）、その他は、売上高 25,590 百万円（同 54.9% 増）、営業利益 597 百万円（同 50.0% 増）となった。

セグメント別売上高・営業利益

（単位：百万円）

	22/3 期		23/3 期		前期比	
	実績	売上比	実績	売上比	増減額	増減率
売上高	133,821	100.0%	210,810	100.0%	76,989	57.5%
半導体等装置関連	90,280	67.5%	132,194	62.7%	41,914	46.4%
真空シール・金属加工	18,858	14.1%	27,976	13.3%	9,118	48.4%
石英製品	21,217	15.9%	28,837	13.7%	7,620	35.9%
シリコンパーツ	8,565	6.4%	17,542	8.3%	8,977	104.8%
セラミックス	18,816	14.1%	27,194	12.9%	8,378	44.5%
CVD-SiC	2,975	2.2%	4,812	2.3%	1,837	61.7%
EB ガン・LED 蒸着装置	7,921	5.9%	8,036	3.8%	115	1.5%
ウエーハ加工	59	0.0%	236	0.1%	177	300.0%
再生ウエーハ	98	0.1%	1,501	0.7%	1,403	-
装置部品洗浄	9,672	7.2%	12,170	5.8%	2,498	25.8%
石英坩堝	2,100	1.6%	3,891	1.8%	1,791	85.3%
電子デバイス	27,023	20.2%	53,024	25.2%	26,001	96.2%
サーモジュール	17,635	13.2%	23,266	11.0%	5,631	31.9%
パワー半導体基板	8,473	6.3%	20,011	9.5%	11,538	136.2%
磁性流体・その他	916	0.7%	936	0.4%	20	2.2%
センサ	-	0.0%	8,811	4.2%	8,811	-
その他	16,517	12.3%	25,590	12.1%	9,073	54.9%
営業利益	22,600	16.9%	35,042	16.6%	12,442	55.1%
半導体等装置関連	15,804	-	24,090	-	8,286	52.4%
電子デバイス	6,689	-	11,178	-	4,489	67.1%
その他	398	-	597	-	199	50.0%
調整額	-291	-	-824	-	-	-

注：ウエーハ加工は 21/3 期第 4 四半期より連結対象外

出所：決算短信、決算説明資料よりフィスコ作成

主要なサブセグメントの状況は以下のとおり。

(1) 真空シール・金属加工、ウエーハ加工・再生ウエーハ

半導体製造装置メーカーからの金属加工受託事業の需要が拡大、常山新工場がフル稼働し、真空シール・金属加工の売上高は 27,976 百万円（前期比 48.4% 増）となった。

フェローテックホールディングス

6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)

<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

業績動向

ウエーハ加工は、2021 年 3 月期の第 4 四半期から持分法適用・非連結化となったが、持分子会社の売上増により売上高は 236 百万円（同 300.0% 増）となった。2022 年 3 月期から立ち上がった再生ウエーハは、売上高は 1,501 百万円（前期 98 百万円）と堅調な立ち上がりとなった。

(2) 半導体マテリアル、洗浄事業

石英製品は、常山工場・東台工場のフル稼働が寄与し、売上高は 28,837 百万円（同 35.9% 増）となった。シリコンパーツの売上高は、銀川工場の能力増強が寄与して 17,542 百万円（同 104.8% 増）となった。セラミックスは、ファインセラミックス杭州工場の能力増強・フル稼働が寄与、プローブカード向けも需要が増加したことから、売上高は 27,194 百万円（同 44.5% 増）となった。CVD-SiC は、中国顧客の需要が好調、岡山工場の能力増強が寄与して売上高は 4,812 百万円（同 61.7% 増）となった。装置部品洗浄は、中国の半導体メーカー、FPD メーカーの生産拡大に伴う需要を取り込み、売上高は 12,170 百万円（同 25.8% 増）となった。

(3) サーモモジュール

5G 通信システム機器向け及び PCR 検査機など医療検査機器向けの伸長が著しく、売上高は 23,266 百万円（同 31.9% 増）となった。

(4) パワー半導体基板

パワーデバイス市場が拡大、中国東台工場の産業機器・民生品向け DCB 基板の生産能力増強が寄与し、売上高は 20,011 百万円（同 136.2% 増）となった。特に自動車・EV 向けの AMB 基板の増加が顕著であった。製品開発機能の強化を進め、DCP 基板等の製品開発を推進中。

3. 主な設備投資と減価償却費

2023 年 3 月期の設備投資額は 62,661 百万円（前期は 35,378 百万円）となった。主な投資は、金属加工、石英製品、シリコンパーツ、セラミックスの常山工場、石英坩堝の銀川工場、セラミックスの石川工場、パワー半導体基板の四川工場、中国本部建物、再生ウエーハ銅陵工場などであった。減価償却費は 12,618 百万円（同 8,085 百万円）と大幅に増加した。

■ 今後の見通し

2024 年 3 月期は半導体関連が一服で営業利益は前期比 7.3% 減予想 石英坩堝、パワー半導体基板は続伸を見込む

1. 2024 年 3 月期の業績見通し

2024 年 3 月期の業績は、売上高 220,000 百万円（前期比 4.4% 増）、営業利益 32,500 百万円（同 7.3% 減）、経常利益は 30,000 百万円（同 29.3% 減）、親会社株主に帰属する当期純利益は 18,000 百万円（同 39.4% 減）を見込んでいる。

フェローテックホールディングス

6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)

<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

今後の見通し

世界的に半導体業界が調整期にあることから、半導体等装置関連の主な製品は減収を予想している。ただし、太陽光発電向け大口経シリコン用に需要が期待できる石英坩堝と、引き続き高い需要が見込まれるパワー半導体基板は大幅増収を予想しており、半導体等装置関連の減収を補う計画だ。売上高の増加が小幅に止まることに加え、減価償却費が大幅増となることから営業利益は減益予想となっている。また営業外損益においては、前期のような為替差益等を見込まないことから、経常利益の減益幅は営業利益より大きくなる見込みだ。さらに特別損益でも、特別利益等は発生しない予想であることから、親会社株主に帰属する当期純利益の減益幅はさらに大きくなる予想である。

設備投資額は 96,900 百万円（前期比 54.6% 増）、減価償却費も 17,400 百万円（前期 12,618 百万円）と大幅増の予定。為替レートは、米ドル 130.00 円（前期 132.08 円）、人民元 19.00 円（同 19.50 円）の前提。

セグメント別売上高は、半導体等装置関連が前期比 5.4% 減、電子デバイスが同 33.4% 増、その他が同 5.4% 減を予想している。

2024 年 3 月期の業績見通し

（単位：百万円）

	23/3 期		24/3 期		前期比	
	実績	売上比	予想	売上比	増減額	増減率
売上高	210,810	100.0%	220,000	100.0%	9,190	4.4%
半導体等装置等関連	132,194	62.7%	125,060	56.8%	-7,134	-5.4%
真空シール・金属加工	27,976	13.3%	25,250	11.5%	-2,726	-9.7%
石英製品	28,837	13.7%	22,420	10.2%	-6,417	-22.3%
シリコンパーツ	17,542	8.3%	14,840	6.7%	-2,702	-15.4%
セラミックス	27,194	12.9%	20,680	9.4%	-6,514	-24.0%
CVD-SiC	4,812	2.3%	6,450	2.9%	1,638	34.0%
EB ガン・LED 蒸着装置	8,036	3.8%	6,080	2.8%	-1,956	-24.3%
ウエーハ加工	236	0.1%	160	0.1%	-76	-32.2%
再生ウエーハ	1,501	0.7%	1,620	0.7%	119	7.9%
装置部品洗浄	12,170	5.8%	11,560	5.3%	-610	-5.0%
石英坩堝	3,891	1.8%	16,000	7.3%	12,109	311.2%
電子デバイス	53,024	25.2%	70,720	32.1%	17,696	33.4%
サーモジュール	23,266	11.0%	21,360	9.7%	-1,906	-8.2%
パワー半導体基板	20,011	9.5%	36,010	16.4%	15,999	80.0%
磁性流体・その他	936	0.4%	1,030	0.5%	94	10.0%
センサ	8,811	4.2%	12,320	5.6%	3,509	39.8%
その他	25,590	12.1%	24,220	11.0%	-1,370	-5.4%
売上総利益	72,081	34.2%	70,500	32.0%	-1,581	-2.2%
販管費	37,038	17.6%	38,000	17.3%	962	2.6%
営業利益	35,042	16.6%	32,500	14.8%	-2,542	-7.3%
経常利益	42,448	20.1%	30,000	13.6%	-12,448	-29.3%
親会社株主に帰属する 当期純利益	29,702	14.1%	18,000	8.2%	-11,702	-39.4%
設備投資額	62,661	-	96,900	-	34,239	54.6%
減価償却費	12,618	-	17,400	-	4,782	37.9%

注：ウエーハ加工は 21/3 期第 4 四半期より連結対象外

出所：決算説明資料よりフィスコ作成

本資料のご利用については、必ず巻末の重要事項（ディスクレマー）をお読みください。

Important disclosures and disclaimers appear at the back of this document.

フェローテックホールディングス

6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)

<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

今後の見通し

2. セグメント別見通し

セグメント別売上高、サブセグメント別売上高の予想は以下のとおり。

(1) 真空シール・金属加工、ウエーハ加工・再生ウエーハ

半導体市況の悪化を受け、半導体製造装置向け金属加工の需要が減少、真空シール・金属加工の売上高は 25,250 百万円（前期比 9.7% 減）と減収予想。

ウエーハ加工の売上高も半導体市況の悪化を受け縮小する見込みだが、再生ウエーハの売上高は 1,620 百万円（同 7.9% 増）と予想している。再生ウエーハ事業は、今期中に黒字化を目指す。

(2) 半導体マテリアル、洗浄事業

市況悪化を受けた顧客の在庫調整等の影響により、石英製品の売上高は 22,420 百万円（同 22.3% 減）を、シリコンパーツの売上高は 14,840 百万円（同 15.4% 減）を見込む。セラミックスは、半導体設備投資の減少や顧客の在庫調整の影響で、売上高は 20,680 百万円（同 24.0% 減）を見込む。CVD-SiC は、顧客からの需要は底堅く、能力を増強した岡山工場の増産により、売上高は 6,450 百万円（同 34.0% 増）の見込み。装置部品洗浄は、半導体市況の低迷を受けて需要は減少する見通しで、売上高は 11,560 百万円（同 5.0% 減）を見込む。石英坩堝は、太陽光発電向け大口径シリコン用の需要が高まっており、売上高は 16,000 百万円（同 311.2% 増）と大幅増が見込まれている。特に下半期にかけて大きく伸びる予想である。

(3) サーモモジュール

前期まで好調だった 5G 通信システム機器向け及び PCR 検査機など医療検査機器向けの需要低減が予想され、売上高は 21,360 百万円（同 8.2% 減）を見込む。

(4) パワー半導体基板

産業機器・民生品向け DCB 基板の需要はさらに拡大する予想となっており、生産能力の増強継続により、売上は大幅増を見込む。一方で、自動車・EV 向け AMB 基板も成長が継続する見込みであることから、売上高は 36,010 百万円（同 80.0% 増）と大幅増予想となっている。

新株予約権付社債発行で 250 億円を調達

3. 設備投資額と減価償却費の見通し

設備投資額は 96,900 百万円（前期比 54.6% 増）と引き続き高水準の投資を計画している。主な投資内容はマレーシア（セラミックス、石英製品、金属加工等）、常山（シリコンパーツ等）、四川（パワー半導体基板）など。これに伴い、減価償却費も 17,400 百万円（前期 12,618 百万円）と大幅増の予定。

フェローテックホールディングス
6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

今後の見通し

また同社は、上記の設備投資に充当する目的で、2028 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（社債の総（2023/6/7 リリース）額 250 億円、2023 年 6 月 23 日払い込み、転換価額 4,020 円）の発行を決議した。

■ 中長期の成長戦略

中期経営計画目標を下方修正したが、2025 年 3 月期以降は再び成長路線へ。2026 年 3 月期に営業利益 600 億円を目指す

1. 中期経営計画の概要（目標値の修正）

同社では、2021 年 5 月（2021/5/28 リリース）に中期経営計画（2022 年 3 月期～2024 年 3 月期）を発表したが、その後の業績が好調であったことから、2022 年 5 月にこの計画の目標値を上方修正した。しかし現在の半導体業界を取り巻く環境は 2022 年 5 月の見込みよりは厳しいものとなっていることを踏まえ、2023 年 5 月に目標値を下方修正した。現在では売上高 2,200 億円、営業利益 325 億円（営業利益率 14.8%）、親会社株主に帰属する当期純利益 180 億円を目標としている。ただし下方修正したとはいえ、当初の計画よりは大きく上回っている。

中期経営計画目標値の推移

（単位：億円）

	当初計画	2022 年 5 月修正	2023 年 5 月修正
売上高	1,500	2,300	2,200
営業利益	250	400	325
（営業利益率）	16.7%	17.4%	14.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	150	210	180

出所：決算説明資料よりフィスコ作成

2. 基本方針と定量的目標（KPI）

（1）基本方針

基本方針は変わっておらず、以下の重要施策を実行していく。

（事業成長）

- ・成長の徹底追及、積極投資を継続
- ・既存事業の競争力強化・シェアアップに加え、非半導体事業の強化を推進
- ・「車載セクター」を新設・戦略的に強化（2024 年 3 月期第 1 四半期から計数開示、2025 年 3 月期から開示セクターに）
- ・製品開発や M&A 等により、事業・製品の多様化を加速

フェローテックホールディングス
6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

中長期の成長戦略

(グローバル生産体制の強化)

- ・ マレーシア拠点の早期稼働
- ・ 石川工場の増強、熊本工場の立ち上げにより「日本回帰」を推進

(経営基盤の強化)

- ・ 品質管理の強化を継続
- ・ デジタル化・自動化・AI 化・見える化を継続推進
- ・ 人材強化の継続

(財務・株主還元)

- ・ 投資機会と財務の適切なバランス確保、当期純利益重視・ROIC 管理強化を継続
- ・ 収益増強により株主還元を増加させていく基本方針、配当性向 20% を意識

(2) 主な数値目標

中期経営計画の目標値を下方修正したが、同時に 2025 年 3 月期及び 2026 年 3 月期の目標値を発表した。2025 年 3 月期に売上高 2,700 億円、営業利益 450 億円、2026 年 3 月期に売上高 3,600 億円、営業利益 600 億円を掲げている。今後の動向に注目したい。

中期経営計画 KPI

(金額の単位は百万円)	中期経営計画 (2022/3期~2024/3期)			目標値	
	22/3期(実)	23/3期(実)	24/3期(予)	25/3期(計)	26/3期(計)
売上高	133,821	210,810	220,000	270,000	360,000
営業利益	22,600	35,042	32,500	45,000	60,000
営業利益率	16.9%	16.6%	14.8%	16.7%	17.5%
当期純利益	26,659	29,702	18,000	25,000	36,000
ROE	26.9%	16.6%	15%目標		
ROIC*	15.8%	11.9%	8%目標		
自己資本比率	49.5%	44.7%	40%目標		
投資額**	35,378	62,661	96,900	60,000程度	未定
1株当たり配当金 (年間)	50.0円	105.0円	100.0円		

※ *ROIC = 親会社株主純利益/(有利子負債+純資産) 純資産は新株予約権、非支配株主持分除く

**投資額は、有形資産、無形固定資産、有価証券の取得等の合計 M&A投資機会により変動する

出所：決算説明資料より掲載

(3) 主な工場新設・生産能力増強の状況

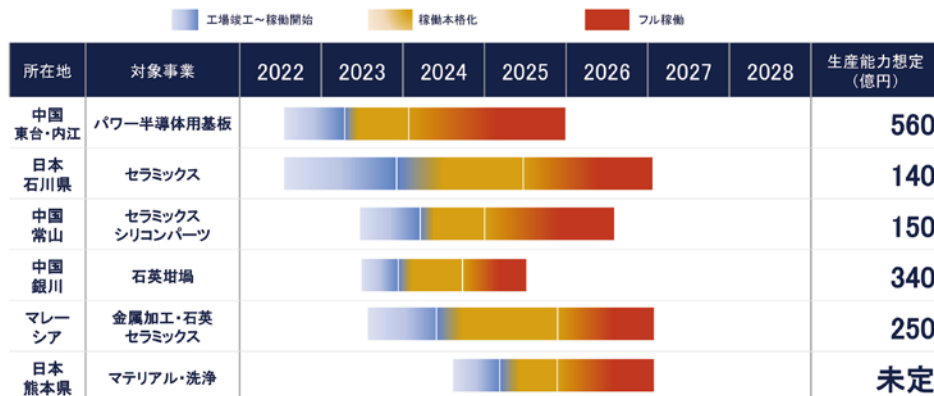
2024 年 3 月期の設備投資額は 96,900 百万円の予定で、2025 年 3 月期には約 60,000 百万円になる見込み。

フェローテックホールディングス
6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)
https://www.ferrotec.co.jp/ir/

中長期の成長戦略

主な工場新設・生産能力増強の状況



出所：決算説明資料より掲載

(4) 主な子会社の上場スケジュール

中国部品洗浄事業子会社は、2022 年 12 月 30 日に深セン創業板市場に上場済み。(公募価格 8.48 元)。また
パワー半導体基板子会社は上場可能時期が不透明のため証券会社とのアドバイザー契約を一旦解除し、現在は
調整中。

子会社の上場スケジュール

事業	部品洗浄	石英増幅・シリコンパーツ	パワー半導体用基板	シリコンウエーハ（持分法）
会社名	安徽富泰徳科技发展股份有限公司	寧夏富泰徳半導体科技股份有限公司	江蘇富泰華半導体科技股份有限公司	杭州中欣晶圓半導体股份有限公司
略称	FTSVA	FTNC	FLH(IBFTSJ)	CCMC
現在の出資比率	50.23%*	60.13%	55.10%	23.05%
上場市場	深セン・創業板	深セン・主板	上海・科创板	上海・科创板
上場アドバイザー	光大証券	東方証券承销保荐	華泰綜合証券	海通證券
直近評価額	544億円（上場公募価格）	1,053億円	1,463億円	2,813億円
新株発行予定比率	25%	25%	25%	25%
上場アドバイザー登録	2020/8/11	2021/11/4	—	2021/10/20
上場申請提出	2021/6/28	2023年上期(目)	未定	2022/8/30
上場審査合格	2022/5/6	—	—	—
上場正式承認	2022/11/16	—	—	—
上場予定日	2022/12/30	2024年後半(目)	未定	2023年後半(目)

*FTSVA出資比率は上場後の数値を記載。

**評価額は2021年以降の第三者割当増資時に算定した株価で計算。人民幣19.01

出所：決算説明資料より掲載

3. 2026 年 3 月期の目標

同社は、2026 年 3 月期の目標を発表した。以下、その概要である。

(1) セグメント別数値目標

2026 年 3 月期におけるセグメント別売上高目標は、半導体等装置関連が 235,600 百万円（2023 年 3 月期
実績 132,194 百万円）、電子デバイスが 93,390 百万円（同 53,024 百万円）、その他が 31,010 百万円（同
25,590 百万円）となっている。

フェローテックホールディングス
6890 東証スタンダード市場

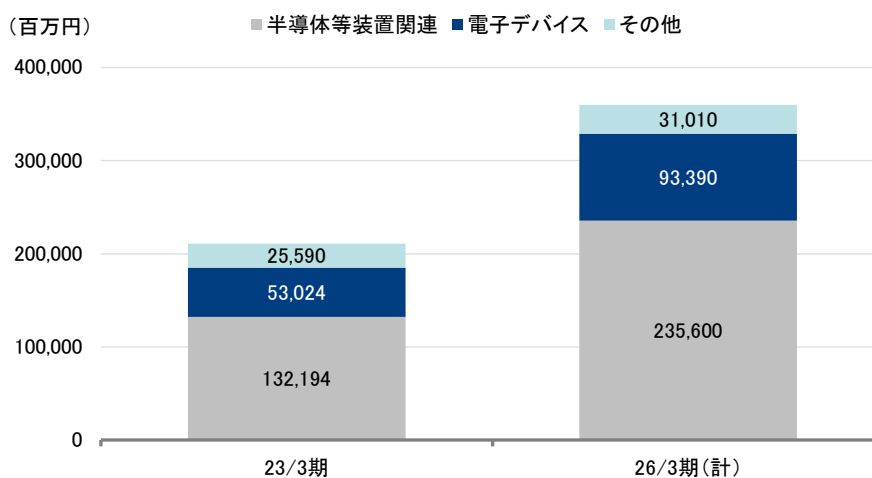
2023 年 6 月 22 日 (木)
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

中長期の成長戦略

半導体等装置関連では、グローバル生産体制の拡充、自動化等を着実に進めており、需要回復時には急速な売上拡大が見込める。主な増設・増強は、常山（石英製品、金属加工、シリコンパーツ等）、マレーシア（金属加工、石英製品、セラミックス）、石川（セラミックス）、岡山（CVD-SiC）など。

電子デバイスでは、パワー半導体基板の四川工場設立による増産体制を着実に進めており、2024 年には生産本格化見通しである。

セグメント別売上高



出所：決算説明資料よりフィスコ作成

(2) カテゴリー別売上高目標

2026 年 3 月期における各カテゴリー別の売上高目標は、半導体マテリアル（石英製品、セラミックス、シリコンパーツ、CVD-SiC 等）が 117,100 百万円（2023 年 3 月期比 49.4% 増）、半導体サービス（部品洗浄、石英坩堝、再生ウエーハ等）が 53,430 百万円（同 200.2% 増）、半導体金属・装置（真空シール、金属加工、蒸着装置等）が 65,070 百万円（同 80.7% 増）、電子デバイス（サーモモジュール、パワー半導体基板、センサ、磁性流体）が 93,390 百万円（同 76.1% 増）、その他（刃物、クリーニング、その他製造装置等）が 31,010 百万円（同 21.1% 増）で、半導体等装置関連のみの合計売上高は、235,600 百万円（同 78.2% 増）である。

フェローテックホールディングス
6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

中長期の成長戦略

カテゴリー別目標売上高

	カテゴリー	製品構成	23/3期 実績	26/3期 (目標)	増減率 (23/3期対26/3 期)
A	半導体 マテリアル	石英 セラミックス シリコンパーツ、 CVD-SiC等	78,385	117,100	+49.4%
B	半導体 サービス	部品洗浄、るつぼ、 再生ウエーハ等	17,798	53,430	+200.2%
C	半導体金属・ 装置	真空シール 金属加工、 蒸着装置等	36,012	65,070	+80.7%
D	電子 デバイス	サーモモジュール パワー半導体基板、 センサ、磁性流体	53,024	93,390	+76.1%
E	その他	刃物、クリーニング、 その他製造装置等	25,591	31,010	+21.2%
A+B+C+ D+E	総合計 (連結売上高)		210,810	360,000	+70.8%
A+B+C	半導体等装 置関連のみ 計	マテリアル/サービ ス/金属・装置計	132,194	235,600	+78.2%

出所：決算説明資料より掲載

(3) 主な戦略製品の状況と見通し

a) 半導体マテリアル：需要は旺盛、生産能力を増強中

半導体前工程製造装置市場は、2024 年 3 月期は調整局面の予想だが、中長期での市場成長の見方は不変。
2026 年 3 月期以降の市況拡大を見越し、各製品の生産能力拡大を継続する。

石英製品：マレーシア・熊本に新工場を建設

セラミックス：マレーシア・石川に新工場建設

※ CVD-SiC は岡山、常山（新工場）、シリコンは常山で拡大予定

フェローテックホールディングス

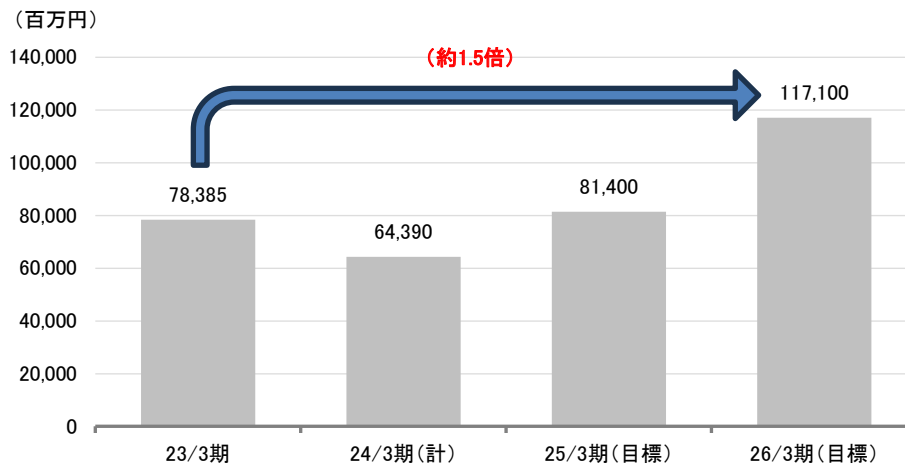
6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)

<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

中長期の成長戦略

半導体材料

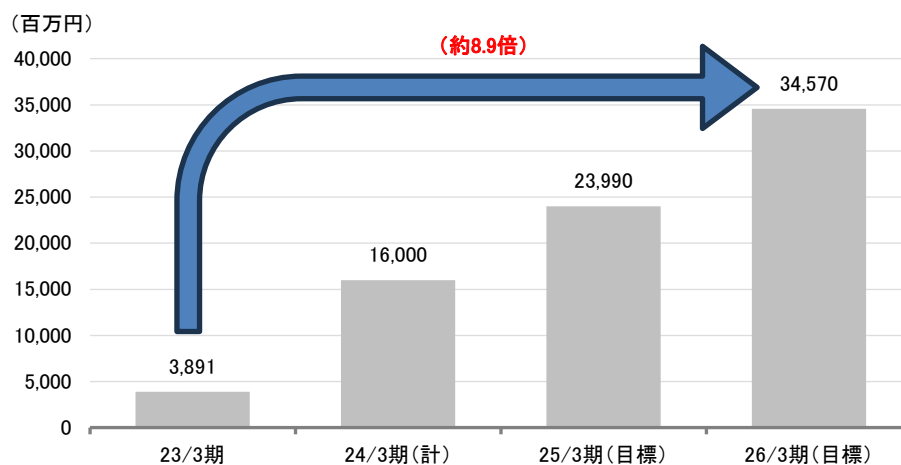


出所：決算説明資料よりフィスコ作成

b) 石英坩堝

2023 年 3 月期の売上高は前期比 85.3% 増、2024 年 3 月期も前期比 311.2% 増の見通し。太陽電池市場の導入量拡大、及びウェーハサイズの大口径化に対応した石英坩堝の大口径化のトレンドが顕著となり、銀川工場での生産能力増強投資を推進中。2026 年 3 月期には、2023 年 3 月期実績比で、約 8.9 倍の売上規模を目標としている。同社の調べでは、太陽電池ウェーハサイズ別市場シェアは、2021 年には 210mm 以上が 13.0%、182 ~ 210mm が 27.0% であったが、2023 年にはそれぞれ 35.0%、59.0% へ上昇したもので、この傾向は今後も続く予想される。

石英坩堝



出所：決算説明資料よりフィスコ作成

フェローテックホールディングス

6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)

<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

中長期の成長戦略

c) パワー半導体基板

世界的に自動車の EV 化が進むなかで、IGBT などのパワー半導体の需要は強く、同社のパワー半導体基板の需要も当面は強いと予想される。2023 年 3 月期は前期比 136.2% 増となったが、2024 年 3 月期も前期比 180.0% 増の見通しで成長は持続する。これに対応して、四川省内江に新工場を竣工された。さらに東台のパワー半導体基板工場は生産能力を拡大中で 2025 年 3 月期以降も増収の見通し。

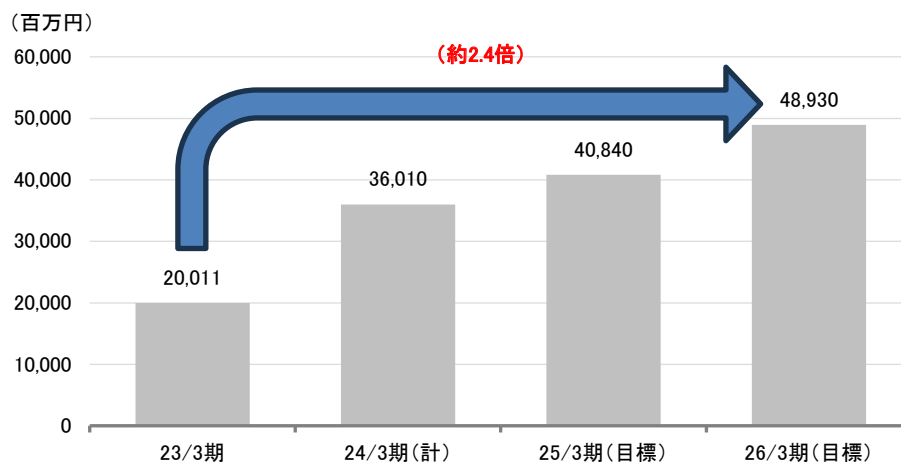
現在、上海・東台工場の DCB 基板月産能力は 110 万枚だが、160 万枚へ増設予定。また AMB 基板も 20 万枚から 45 万枚へ増産を計画中。高耐熱・高強度の DPC 基板も、光通信やパワー LED 製品等への展開を強化している。世界的な消費電力抑制気運から、DCB 基板はさらに需要拡大の見込みで、車載用途で、AMB 基板も一定水準の売上規模になると予想されている。同社では、2026 年 3 月期の売上高 48,930 百万円（2023 年 3 月期比で約 2.4 倍）を見込んでいる。

DCB 基板 (Direct Copper Bonding)：材質はアルミナセラミックス

AMB 基板 (Active Metal Brazing)：材質は窒化ケイ素

DPC 基板 (Direct Plated Copper)：材質はアルミナセラミックス等メタライズ (Ni 等)

パワー半導体基板



出所：決算説明資料よりフィスコ作成

4. グローバル戦略の強化

(1) 東南アジア：マレーシア新拠点

2022 年 4 月にマレーシアケダ州クリム・ハイテクパーク内（ペナン島近隣）に製造子会社 Ferrotec Manufacturing Malaysia を設立した。新工場を建設中で、2023 年 11 月頃竣工予定。東南アジア顧客に密着した事業展開（石英製品・セラミックス・金属加工 / 組立等）を進める。

フェローテックホールディングス
6890 東証スタンダード市場

2023 年 6 月 22 日 (木)
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

中長期の成長戦略

(2) 日本：石川増強、熊本新拠点

中長期での需要拡大が見込まれる半導体製造装置関連部材「ファインセラミックス」「マシナブルセラミックス」の増産を石川エリアで対応中。既に 2022 年 11 月に第 2 工場が竣工、第 3 工場も用地を確保し、2024 年半ばに竣工予定。

またシリコンアイランド」九州の熊本県大津町に生産拠点を新設予定（2024 年 6 月竣工予定）で、半導体マテリアル製品、装置部品洗浄の事業展開を計画している。

5. 経営基盤の強化

(1) 生産現場のデジタル化・自動化・見える化を水平展開

中国生産拠点で ERP、MES をはじめ様々なシステム導入が進み、生産の見える化、効率化、品質の向上が実現（AI 活用、ロボットの積極導入など）した。今後は、日本、マレーシアの新拠点でも自動化投資を積極的に進め、水平展開を図るとともに、モノづくりにおける DX を推進し、生産性及び品質の向上に取り組む。

(2) 人材強化：優秀な人材の確保、人材育成への対応を国内外で展開

日本、中国、マレーシアなど、事業拡大を進めるエリアでのブランディングを強化し、優秀な人材の確保を推し進める。また、グループ内で 2023 年を「学びの年」と位置付け、「常に最新の技術や知識を学び、技術革新や新製品の創出に取り組める」企業文化の構築に取り組む。

日本では石川・熊本などの事業拡大エリアを中心に 6 月以降ブランディングを強化し、優秀な人材確保を進める。（TVCM 放映、駅サイネージ広告ほか、グループ知名度の向上を図る）

中国では、上海に中国本部機能を統合するため、新ビルを建設した。上海での研究開発人員採用、及び中国内ブランディングを強化する。中国内の大学、研究機関との関係を強化し優秀な人材を確保する。

株主還元策

2024 年 3 月期は年間 100 円配当の予定

同社は株主還元策として配当を実施している。年間配当として、2019 年 3 月期、2020 年 3 月期は 24 円、2021 年 3 月期は記念配当 4 円（創立 40 周年）を含めて 30 円、2022 年 3 月期は 50 円配当を行った。2023 年 3 月期は、当初は年間 70 円配当の予定であったが、業績が好調であったことから同 105 円配当（配当性向 16.3%）を行った。2024 年 3 月期については、現時点では年間 100 円配当（予想配当性向 26.1%）を発表済みだ。

高水準の設備投資を続けながらも、少しずつだが増配を行っている点は評価できる。今後の配当政策にも注目したい。

重要事項（ディスクレマー）

株式会社フィスコ（以下「フィスコ」という）は株価情報および指数情報の利用について東京証券取引所・大阪取引所・日本経済新聞社の承諾のもと提供しています。

本レポートは、あくまで情報提供を目的としたものであり、投資その他の行為および行動を勧誘するものではありません。

本レポートはフィスコが信頼できると判断した情報をもとにフィスコが作成・表示したのですが、フィスコは本レポートの内容および当該情報の正確性、完全性、的確性、信頼性等について、いかなる保証をするものではありません。

本レポートに掲載されている発行体の有価証券、通貨、商品、有価証券その他の金融商品は、企業の活動内容、経済政策や世界情勢などの影響により、その価値を増大または減少することもあり、価値を失う場合があります。本レポートは将来のいかなる結果をお約束するものでもありません。お客様が本レポートおよび本レポートに記載の情報をいかなる目的で使用する場合においても、お客様の判断と責任において使用するものであり、使用の結果として、お客様になんらかの損害が発生した場合でも、フィスコは、理由のいかんを問わず、いかなる責任も負いません。

本レポートは、対象となる企業の依頼に基づき、企業への電話取材等を通じて当該企業より情報提供を受けて作成されていますが、本レポートに含まれる仮説や結論その他全ての内容はフィスコの分析によるものです。本レポートに記載された内容は、本レポート作成時点におけるものであり、予告なく変更される場合があります。フィスコは本レポートを更新する義務を負いません。

本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権はフィスコに帰属し、フィスコに無断で本レポートおよびその複製物を修正・加工、複製、送信、配布等することは堅く禁じられています。

フィスコおよび関連会社ならびにそれらの取締役、役員、従業員は、本レポートに掲載されている金融商品または発行体の証券について、売買等の取引、保有を行っているまたは行う場合があります。

以上の点をご了承の上、ご利用ください。

■お問い合わせ■

〒107-0062 東京都港区南青山 5-13-3

株式会社フィスコ

電話：03-5774-2443（IR コンサルティング事業本部）

メールアドレス：support@fisco.co.jp